

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称	广发基金、诺安基金、天弘基金、太平基金、华商基金、中航基金、兴业基金、红塔红土基金、东吴基金、中加基金、南华基金、富安达基金、光大保德信基金、易米基金、淳厚基金、国开泰富基金、悦溪基金、泰康养老保险、光大永明保险、中荷人寿保险、昆仑健康保险、新华养老保险、长江养老保险、太平资产、多鑫投资、海金投资、明河投资、磐厚动量资管、合众易晟投资、笃诚投资、富业盛德资管、志开投资、聆泽投资、玄元投资、榕树投资、混沌投资、仁桥资产、尚雅投资、汇信聚盈基金、聚鸣投资、南京港湾资管、正圆投资、中津创新投资、和聚投资、三亚鸿盛资管、慈阳投资、幻方量化投资、广银理财、中邮理财、中信建投资管、长江资管、华安资管、海通资管、建信信托、PAG、Kontiki Capital、方正证券、山西证券、海通证券、财通证券、长城证券、东吴证券、招商证券、浙商证券、长江证券
时间	2023年2月2日-10日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：高健 证券事务代表：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：晶圆代工项目建设进展如何，后续是否会新建 8 寸或 12 寸的产线？</p> <p>答：广芯微电子项目的厂房建设及机电安装等工程已基本完成，目前生产设备开始陆续进场开始安装调试，以及二次配管的进场准备工作；广芯微电子团队成员已有一百多人，核心团队配置完备，其中不少是在国内外大厂工作二三十年的高管和技术骨干。由于春节前丽水市处于新冠感染高峰期，对项目工期有所影响，目前项目已恢复正常建设，预计今年上半年完成通线量产工作。</p>

广芯微电子项目一期规划产能为10万片/月（6英寸），同时已在一期项目旁预留了二期建设用地，待一期项目量产后，将逐步开启项目二期建设。二期规划建设8英寸或12英寸晶圆代工产能，已委托专业设备公司持续关注合适的整线设备，如有合适的设备将及时参与竞拍购买。如进展顺利，今年年底可启动二期厂房的建设。

问题 2：如何看待目前功率器件后续的价格变化和未来市场前景，公司是否会面临代工产能过剩的情况？

答：功率半导体市场，同半导体整体市场一样，与经济周期波动呈强相关性，尤其下游应用是在消费类场景的产品。就国内功率半导体市场而言，部分中低端产品的产能供给过剩，尤其在经济和消费低迷时更为凸显；但可以做到进口替代的中高端产品产能却始终严重不足，进口替代空间广阔。因此，在国家“碳达峰、碳中和”战略以及“深化供给侧结构性改革”战略下，先进功率器件产业链产能的供给将更为稀缺、更有价值。

广芯微电子致力于成为国内功率半导体晶圆代工厂的典范，定位中高端功率器件的晶圆代工业务，中高端功率器件代工产能及超薄片背道代工产能均为国内稀缺资源，且依托公司 smart IDM 生态圈的产业协同能力，较传统模式更具开放性和竞争力。

问题 3：公司功率器件新产品的进展情况怎样？

答：公司在功率半导体硅基器件和碳化硅器件领域均是基于供应链自主可控的战略进行布局。

新产品方面，公司控股的功率半导体设计公司广微集成，去年在12英寸晶圆代工厂开发的SGT-MOSFET产品，60V系列产品已量产，80V、100V系列产品已完成工程批并预计今年上半年量产，如进展顺利，下半年将启动150V、200V产品开发工作，今年SGT-MOSFET产品有望为广微集成贡献显著收入增长；此外，伴随广芯微电子通线投产，今年还计划量产的产品包括：900-1500V高压MOS、IGBT、FRD以及SiC器件等产品。

问题 4：请介绍下子公司的研发和业务协同情况，以及总公司是如何对子公司进行管理的？

答：民德电子近几年致力于打造 smart IDM 生态圈模式，即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链。在这种模式下，民德电子对产业链上下游各环节企业均保持足够影响力，但不谋求拥有，既保证了产业链上下游公司紧密合作，以实现特色工艺和供应链的安全稳定，又使得产业链上各家公司保持了独立的组织架构、

	<p>自主的产品发展规划、充分的市场竞争意识和广阔的国际化发展空间。</p> <p>公司目前已完成了晶圆制造（广芯微电子）、超薄片背道加工（芯微泰克）、外延片制造（晶睿电子）、芯片设计（广微集成、丽隽半导体）等关键环节的布局，每个环节由一位科学家级的产业领军人物带领，使得各子公司能始终保持充分的市场竞争及技术迭代能力；同时，功率半导体产品属于“特色工艺”的特点，需要在设计、制造、原材料等方面进行特色化定制，以及产业链上下游密切配合，smart IDM 生态圈模式在保持产业链上下游公司独立经营的情况下，相互之间守望相助，有效提升产业链协同效率，使得生态圈内企业有更高效率的运营和开发能力。</p> <p>问题 5：公司在功率半导体全产业链进行布局，资金方面是否有保障？</p> <p>答：目前功率半导体各环节项目的资金均有充分保障。</p> <p>公司控股设计公司广微集成属轻资产经营模式，且已实现盈利，其经营性现金流良好，无需公司再进行投入；参股外延片企业晶睿电子近期融资估值已接近 30 亿元，后续扩产及新项目建设资金都有充分保障。</p> <p>目前处于建设期的晶圆代工厂广芯微电子，项目一期计划投资 12~14 亿元，除民德电子和丽水当地政府基金增资的约 4 亿元，以及上市公司通过定增募资 5 亿元之外，广芯微电子及民德丽水公司获得了多家银行、最长 10 年期的固定资产项目贷款，授信额度超过 6 亿元，满足当前项目建设资金需求。超薄片背道代工企业芯微泰克，已获得包括民德电子、嘉兴璟坤鸣人、仙达科技等 1.2 亿元投资，近期丽水当地政府基金也计划对其进行增资，后续芯微泰克也会开展银行融资和社会股权融资工作，其建设和运营资金充足。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-02-10